

接合用焼結型銅ペースト

Copper Sintering Paste

ELTRACE[®] CP-1006ZN

特長

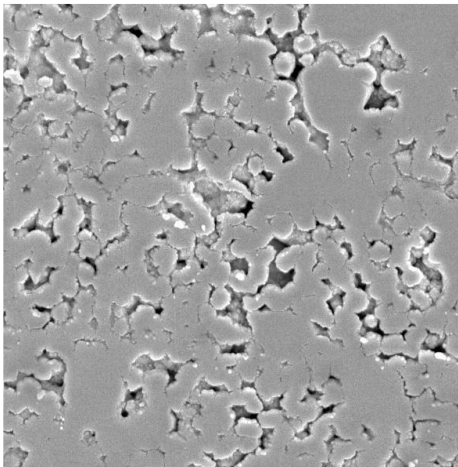
Features

- 大気または窒素雰囲気下での加圧焼成が可能
Sinterable under air or N₂.
- 焼結体は各種金属に対する高い接合強度、放熱性を有する
High thermal conductivity and high bonding strength for various metals.
- 良好な安定性を有し、ステンシルやディスペンサーなど各種塗工方法に対応可能
Good stability and wide adaptability to various coating methods such as stencils or dispensers.

一般特性

General Properties

Item		ELTRACE [®] CP-1006ZN	
Sintering Process	Temperature(°C)	260	
	Pressure(MPa)	20	
	Time(min)	5	
	Atmosphere	Air	N ₂
Properties	Shear Strength (MPa)	30	40
	Thermal Conductivity (W/(m・K))	200	
	Volume Resistivity (μΩ・cm)	4	

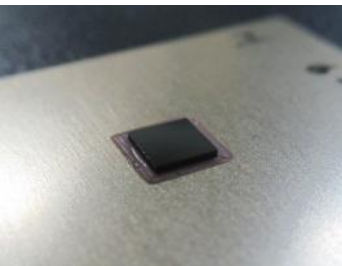
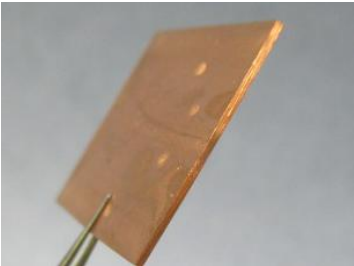


焼結後の断面SEM像
Cross-sectional SEM image after sintering

適用例

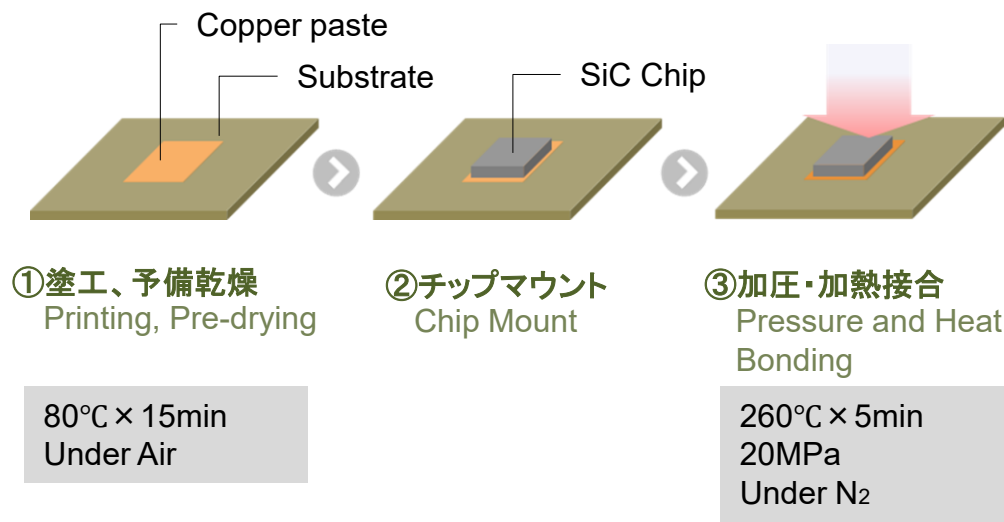
Examples of Application

- 半導体チップ(Si、SiC)の接合
Bonding of semiconductor chips (Si, SiC).
- 銅ポストなどの構造体の形成
Formation of structures, such as copper post.



ダイボンド工程

Die Bonding Process



本資料に記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。 エルトレース、ELTRACEは日油株式会社の登録商標です。
The data listed in this leaflet are typical values and not guaranteed values. ELTRACE is a registered trademark of NOF CORPORATION.